



PRODUCT LINE-UP

東京エレクトロン 製品案内 **2026**



CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

Low particle wafer transfer system

■ 低発塵新搬送方式

Improved Overall Equipment Efficiency (OEE) for litho cells

■ 最新露光機を含めた
リソセルとしてのOEE向上の実現

Reduced Cost of Chemicals (CoC)
and energy usage

■ 薬液コストの大幅な削減および
省エネルギー化

Applications

All lithography processes

■ リソグラフィー全般

CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ AP



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

High throughput/Small footprint

■ ハイスループット/省フットプリント

Improved OEE
(Overall Equipment Efficiency)

■ OEE (Overall Equipment Efficiency) の改善

Special wafer support
(warped wafer, glass wafer,
bonded wafer etc.)

■ 特殊ウェーハ対応
(反りウェーハ、ガラスウェーハ
貼り合わせウェーハ etc)

Applications

Advanced packaging process

■ アドバンスドパッケージプロセス

Polyimide process

■ ポリイミドプロセス

SOG/SOD coating process

■ SOG/SOD塗布プロセス

枚葉洗浄装置 Single Wafer Cleaning System

CELLESTA™ -i



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- High throughput of up to 1,000 wafers per hour
- Damage-free physical cleaning using new atomizing spray
- Unique drying technology that controls watermarks and pattern damage
- Independent control of process environment in each chamber
- Spinner technology compatible with various process chemistries
- 高スループット (最大毎時1,000枚)
- 新2流体スプレーによるダメージレス物理洗浄
- ウォーターマーク、パターン倒壊を抑制する独自乾燥技術
- チャンバーごとのプロセス雰囲気独立制御
- 各種アプリケーション対応スピナー技術

Applications

- Pre-diffusion and pre-CVD cleaning
- Post-etch cleaning
- Wet etch
- Backside and bevel cleaning
- Post-etch polymer removal
- 拡散前/CVD前洗浄
- エッチング後洗浄
- ウェットエッチング
- 裏面・ベベル洗浄
- 配線加工ポリマー除去

オートウェットステーション Auto Wet Station

EXPEDIUS™ -i



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Transfer system with throughput of 1,000wph
- Short-time resist stripping
- Highly selective and stable process for 3D NAND SiN etch process
- New nozzle concept for etch uniformity Improvement (WIW, WTW)
- Equipped with a stacked dual chamber dryer (SD2)
- 毎時1,000枚の搬送能力
- 短時間レジスト剥離処理槽搭載可能
- 高選択比で安定的なプロセスを提供する3D NAND向けSiN選択エッチング
- 新ノズルコンセプトで槽内均一性 (WIW、WTW) 向上
- SD2 (Stacked dual chamber dryer) 搭載

Applications

- Pre-diffusion and pre-CVD cleaning
- Post-etch cleaning and resist strip
- Wet-etch (SiN etch, W recess, Poly Si etch)
- Rework and recycle
- 拡散前/CVD前洗浄
- エッチング後洗浄/レジスト剥離
- ウェットエッチング (SiN etch、W recess、Poly Si etch)
- リワーク/リサイクル

Episode™ UL



製造: 東京エレクトロン宮城
Mfg: Tokyo Electron Miyagi

Features

Maximize space utilization with a flexible arrangement of up to 12 chambers

Make your manufacturing smarter with:

- Multiple sensors for tool health monitoring
- EtherCAT* for high speed process control
- AI/Machine Learning for Big Data analysis
- Auto calibration for tool matching

- 最大12チャンバーまで搭載可能とし、スループット、稼動率、スペース効率などの高生産性最大化を実現したスマートツール
 - 多数のセンサー設置による安定稼動
 - EtherCAT*による高速モニタリングおよび高速制御
 - 機械学習によるビッグデータ解析
 - オートキャリブレーション機能による機差低減

*EtherCAT: Ethernet for Control Automation Technology (産業用オープンネットワーク)

*EtherCATは、Beckhoff Automation GmbH の登録商標です。

*EtherCAT is a registered trademark of Beckhoff Automation GmbH.

Applications

Dielectric ■ 絶縁膜

Conductor ■ シリコン

Reactive Ion Etch ■ 反応性イオンエッチング

プラズマエッチング装置

Plasma Etch System

Tactras™



製造: 東京エレクトロン宮城
Mfg: Tokyo Electron Miyagi

Features

- Support up to 6 process chambers and after treatment chambers
- Robust design to minimize offset in machine-to-machine and chamber-to-chamber
- Particle reduction technology
- 最大6個のドライエッチチャンバー、および後処理チャンバーを選択搭載可能
- 装置間、チャンバー間の機差を最小化するロバスト設計
- パーティクル低減技術

Applications

- Dielectric
- Conductor
- Reactive Ion Etch
- 絶縁膜
- シリコン
- 反応性イオンエッチング

Certas LEAGA™



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

Higher productivity with flexible module layout concept

Selective etch of various oxide films

Good controllability of micro-loading and etch profile

カスタマイズ可能なモジュール構成による生産性向上

各種酸化膜に対する選択エッティング

粗密パターンでのローディング低減、エッティング形状コントロールが可能

Applications

Dielectric 絶縁膜

Chemical dry etch ケミカルドライエッティング

TELINDY PLUS™



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Batch ALD process to achieve high step coverage and high productivity
- Seed technology to achieve thin film controllability
- High-speed robotics
- Dry cleaning technology for particle reduction
- 31% reduction of energy consumption per wafer by decreasing L/L N2 flow rate and by higher throughput (SEMI S23 conversion, compared to TELINDY™)
- バッチ式ALDによりカバレッジ性能の確保と高生産性を両立
- シード技術によるCVD膜の薄膜制御性の向上
- 高速搬送メカ
- ドライクリーニング技術による微小パーティクル制御
- L/L N2流量削減、スループット向上によりウェーハ当たりのエネルギー消費量31%削減 (SEMI S23換算、TELINDY™比)

Applications

- Oxide/Anneal/CVD/ALD
- 成膜装置
(酸化/アニール/CVD/ALD装置)

ALD装置

Atomic Layer Deposition System

NT333™



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Thickness controllability at the monolayer level through sufficient gas adsorption and oxidation
- High quality film deposition by taking quality improvement steps into ALD cycles
- SiO₂ film deposited in low temperature regions ($\leq 400^{\circ}\text{C}$) has comparable HF etch resistance and leakage performance to thermal oxide
- Enabling excellent film property uniformity required for high aspect ratio structures on 3D NAND devices at high temperatures (760°C)
- 反応ガスの十分な吸着・酸化による原子レベルでの膜厚制御
- ALDサイクル内への改質ステップ組み込みによる高品質成膜の実現
- 低温域(400度以下)において熱酸化膜同等の耐フッ酸性、リーケ特性の実現
- 高温域(760度成膜)において3D NANDに求められる高アスペクト内の膜質均一性を達成

Applications

- Various and dielectric films
- Thermal and plasma configuration
- 高品質ALD Film プラズマ/サーマル

枚葉成膜装置 Single Wafer Deposition System

Episode™ 1



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Support continuous execution of multiple processes by up to 8 process modules ■ 最大8つのプロセスマジュールにより連続プロセスが可能
- Reduced contact resistance in advanced logic devices by combining OPTCURE™ and ORTAS™ process modules ■ OPTCURE™とORTAS™のプロセスマジュールの組み合わせでコンタクト低抵抗化実現
- Enhanced data collection and edge data processing systems improve equipment availability and engineering efficiency ■ より強化されたデータ収集とエッジ情報処理機能により装置稼動率とエンジニアの作業効率改善を支援

Applications

- Logic contact ■ ロジックコンタクト工程

Episode™ 2 DMR



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

High throughput and minimal footprint by simultaneously transferring two wafers

DMR (Duo Matched Reactor) concept enables simultaneous deposition of two wafers

Succeeding the Triase+™ EX-II™ series, also offers coping with future devices and higher aspect ratios. Enhanced data collection and edge data processing systems improve equipment availability and engineering efficiency

ウェーハ2枚を同時に搬送することにより省フットプリントでの高い生産性を実現

DMR (Duo Matched Reactor) コンセプトによりウェーハ2枚を同時に成膜可能

Triase+™ EX-II™シリーズの後継製品としてさらに将来のデバイスやより高いアスペクト比に対応。より強化されたデータ収集とエッジ情報処理機能により装置稼動率とエンジニアの作業効率改善を支援

Applications

Capacitor electrode

キャパシタ電極

Word line TiN

ワードラインTiN

Barrier metal

バリアメタル

LEXIA™-EX



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Scalable platform concept inherited from EXIM™
- Footprint reduction
- High throughput
- Ultra high vacuum design
- Excellent uniformity
- Best in class CoC and CoO
- 拡張性のあるプラットフォーム
- 省フットプリント
- 高生産性
- 超高真空モジュール
- 優れた膜均一性
- 最高クラスのCoC・CoO

Applications

- Multilayer
- Hardmask
- Logic functional film
- 多層膜
- ハードマスク
- ロジック向け機能膜

Prexa™



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

Automation of operations	■ 自動化オペレーション
High accuracy contact	■ 高精度コンタクト
High speed inspection	■ 高速インスペクション
New software structure	■ 新オペレーションソフトウェアシステム
Advanced safety functions for probe card and wafer	■ プローブカード、ウェーハ安全機構
UTCS (Uniformize Temperature Control System)	■ UTCS (Uniformize Temperature Control System)

Applications

High heat generating device (HPC, GPU, Memory etc.)	■ 高発熱デバイス (HPC、GPU、Memory等)
Small die and fine pitch probing	■ 狹ピッチ/小パッド、プロービング
High pin count and high multi-site SoC and memory	■ 多ピン/多マルチ測定
Full wafer testing	■ フルウェーハテスト
Low noise parametric probing	■ 低ノイズ・パラメトリック測定

WDF™ 12DP+



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Fully automatic dicing frame and standard wafer handling
- Change over kit to easily switch between 300mm and 200mm
- N-Shot alignment for high accuracy, parallelism probing for diced wafer
- Improved system cleanliness and ESD*
- TEL standard prober application software
- ダイシングフレームおよび標準ウェーハ全自動搬送対応
- COK/チェンジオーバーキットでの容易な300/200mm切り替え
- N-Shot アライメントによるダイシング後ウェーハへ高精度・多マルチプロービング
- 装置クリーン度、静電気対策改善
- TEL標準ウェーハプローバーアプリケーションソフトウェア対応

Applications

- Post dicing test for KGD*, RMA*
- Advanced package test capability (WLP, FOWLP, Panel level package)
- Test for thin wafer, multiple PCB, strip frames on dicing frames
- ダイシング後テストによるKGD*保証、およびRMA*
- 先端パッケージテスト (WLP、FOWLP、Panel level package)
- ダイシングシートに貼り付けられた薄ウェーハ、複数のPCB、ストリップフレームテスト

マルチセルテストシステム Multi-Cell Test System

Cellcia™



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

- Asynchronous and simultaneous test in each cell
- Ultra-compact footprint by multi-layer system structure
- TAT reduction by simultaneous test in multiple cells
- Highly reliable front-end equipment wafer robot technology
- 完全に独立したセル構造による複数ウェーハの同時テスト
- 多段積み構造によるフットプリントの大幅削減
- 複数ウェーハ同時処理によりTAT (Turn Around Time) 大幅短縮
- 前工程プラットフォーム技術を応用した高信頼性搬送ロボット

Applications

- 300mm memory device
- Full wafer contact
- 300mm メモリデバイス
- フルウェーハー括コンタクト

ウェーハボンディング/デボンディング装置 Wafer Bonding/Debonding System

Synapse™ V / Synapse™ Z Plus



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing
 - Realizes the entire temporary bonding process
 - Achieves debonding and handling of wafer with 35um or greater thickness
 - Establishes room temperature debonding process
- 本格量産用装置デザイン
 - 接合プロセスに要求される材料塗布からウェーハ接合までの一貫プロセスの実現
 - 剥離プロセスでは35um厚までのウェーハ剥離・洗浄・搬送を実現
 - 常温デボンディング技術の確立による高いプロセスマージンの実現

Applications

- Temporary bonding and debonding for TSV manufacturing
 - Wafer permanent bonding
- TSV用ウェーハ仮接合/剥離
 - 接着剤によるウェーハ永久接合

ウェーハボンディング装置 Wafer Bonding System

Synapse™ Si



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing
- High availability for production
- Excellent alignment accuracy
- Realized high volume manufacturing with Cu hybrid wafer bonding technology
- 本格量産用装置デザイン
- 高い稼動率を実現
- 高いアライメント精度を実現
- Cu ハイブリッドウェーハ接合の量産化を実現

Applications

- Any application requires fusion bonding
- Any application requires Cu hybrid wafer bonding device
- フュージョンウェーハ接合
- Cu ハイブリッドウェーハ接合を利用するあらゆる製品に対応

レーザエッジトリミング装置 Laser Edge Trimming System

Ulucus™ L



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

- Designed for high volume manufacturing
 - Excellent trimming accuracy
 - Latest platform utilizing clean technology from the front-end process, with the integration of laser technology
 - Ensured reduction in DIW* consumption, dust emissions, and waste water discharges
- * Deionized water

■ 本格量産用装置デザイン

■ 高いトリミング精度を実現

■ 前工程レベルのクリーン技術を適用した最新プラットフォームとレーザ技術を融合

■ 純水使用量、粉塵排出量、排水量の削減

Applications

- 300mm wafer to wafer fusion bonding device
- 300mm wafer to wafer Cu hybrid bonding device

■ 300mm フュージョンウェーハ接合を利用する製品

■ 300mm Cu ハイブリッドウェーハ接合を利用する製品

先端レーザ剥離装置 Extreme Laser Lift Off System

Ulucus™ LX



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

Designed for high volume manufacturing

■ 本格量産用装置デザイン

Latest platform utilizing clean technology from the front-end process, with the integration of laser technology

■ 前工程レベルのクリーン技術を適用した最新プラットフォームとレーザ技術を融合

Realize separation of top silicon substrate from Fusion/Cu hybrid bonded silicon substrate using laser technology

■ レーザ技術を用いた永久接合ウェーハの基板分離を実現

Technology for reducing environmental impact by replacing existing thinning processes after Fusion/Cu hybrid bonding

■ ウェーハ永久接合後の既存薄化工程を置き換える環境負荷低減技術

Applications

300mm Wafer to Wafer Fusion/Cu hybrid bonding device

■ 300mm Cu ハイブリッドウェーハ接合および300mm フュージョンウェーハ接合を採用するデバイス

Die to wafer Fusion/Cu hybrid bonding device

■ Cu ハイブリッド Die to wafer接合およびフュージョン Die to wafer接合を採用するデバイス

ウェーハ薄化装置 Wafer Thinning System

Ulucus™ G



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Features

Wafer thinning system for 300mm wafer fabrication

300mmウェーハ製造プロセス向け
ウェーハ薄化装置

Integrating the advanced grinding technology into the latest platform of front-end's super clean technology

前工程レベルのスーパークリーン技術
を適用した最新プラットフォームと
研削加工ユニットを融合

Single-wafer processing units allow control over the quality of each wafer

枚葉加工によりウェーハごとの品質
コントロールが可能

High-quality processing of both sides of wafers

ウェーハの両面加工を高品質で実現

Applications

300mm wafer fabrication

300mmウェーハ製造

ガスクラスター ビーム 装置 Gas Cluster Beam System/Pattern shaping/Trim

Acrevia™



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America Inc.

Features

- Proven Gas Cluster Beam (GCB) technology for low damage etching
- Wafer scanning system with variable tilt to etch feature pattern-sidewalls
- Location Specific Processing (LSP) algorithm to improve within wafer uniformity
- Multiple chemistries for organic and inorganic film etching
- 低ダメージでエッチング可能なガスクラスター ビーム技術
- 傾斜機能付きウェーハスキャンシステムによりパターン側壁をエッチング可能
- LSP (Location Specific Processing) アルゴリズムにより、均一性改善
- 対象の有機膜、無機膜に合わせたガス対応可能

Applications

- Dimension Modification
- WIW Uniformity Control
- Line Edge Roughness (LER) / Line Width Roughness (LWR) improvement
- EUV含む対象パターンの形状補正
- ウェーハ面内均一性制御
- LER (ラインエッジラフネス) / LWR (ライン幅ラフネス) の改善

バッチスプレー式洗浄装置 Batch Spray Cleaning System

ZETA™ +

Features

- 省フットプリントで全自動搬送
Compact footprint with full automation
- 200/300mm対応 (full auto),
100/150/200mm対応
(semi auto)
Available for 200/300mm
(full auto), 100/150/200mm
(semi auto)
- 最大8種類の薬液、
内1種類はリサイクル可
Up to 8 point of use chemicals
and 1 recirculated chemistry
- 高温蒸気SPM処理ViPR™プロセスによりウェーハ上 ~220°Cで処理可能
High temperature SPM ViPR™ process enables processing at ~220°C on wafer
- FEOLウェット処理、インプラ後のレジスト除去、サリサイド除去
FEOL wet steps, implanted photoresist strips and metal silicide strips
- 水性BEOLウェット処理
Aqueous BEOL wet steps
- Si/SiC/AlTiC/Glass/Sapphire



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America

Apps

極低温エアロゾル枚葉洗浄装置 Single Wafer CryoKinetic Cleaning System

ANTARES™

Features

- 微小欠陥異物の高除去性能
High fall-on particle removal efficiency
- 純水、薬液を使用しない固体エアロゾル洗浄
Uses no water or wet chemicals
- 洗浄時のメタルへのエッチおよび腐食防止
Will not etch or corrode metals
- 洗浄時の下地膜ダメージ防止
Will not etch or alter film properties
- 純水洗浄で困難な疎水膜での洗浄可能
Ideal for hydrophobic films



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America

Apps

- DCプローブ後洗浄
Post DC probe
- FEOL High-k膜成膜後洗浄
Post FEOL High-k
- BEOL絶縁膜、Low-k膜成膜後洗浄
Post BEOL dielectric, Low-k
- BEOL CMP後洗浄
Post BEOL CMP
- BEOLエッティング後パーティクル除去洗浄
Post BEOL RIE

CLEAN TRACK™ ACT™ 8Z

Features

- ACT™8からのプロセストレース100%
100% process transfer compatible from ACT™8
- 300mmプロセス装置のバックエンジニアリング
(新レジスト供給システム、超音波流量計採用)
Back-engineering of 300mm process technology
(New resist supply system, Ultrasonic flow meter)
- メンテナンス性能改善
(搬送アーム、自動データバックアップ 等)
Improved maintenance performance
(Handling arm, Automatic data backup etc)
- 対応可能プロセス; i-line, KrF, ArF, SOG/SOD, PI
Available process; i-line, KrF, ArF, SOG/SOD, PI
- SiC,GaNを筆頭にした化合物半導体に対応可能
Available substrate / size:Si, SiC, GaN, Glass, InP etc. / 50~200mm



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Apps

スクラバー洗浄装置 Scrubber System

NS300+ 200mm Conversion

Features

- 4~8チャンバー選択式による高生産性
High productivity with function of SiC thin Wafer
- 進化したスクラバープロセステクノロジー
Advanced scrubber process technology
- システム・プロセスログ管理機能
Machine and process data management system



製造: 東京エレクトロン九州
Mfg: Tokyo Electron Kyushu

Apps

- ウエーハ表面・裏面洗浄/ベベル処理機能
Front-Backside cleaning/Bevel processing function
- 150/200mmのウエーハサイズに対応
Available for 150 and 200 mm wafer
- SMIF Pod/OHT 対応
SMIF pod applicable load ports/OHT applicable
- 多様化するウエーハ素材・仕様に対応
Supports a wide variety and spec of wafer materials
- ポストCMPライトケミカル洗浄
Post CMP cleaning with light chemical
- SiC薄型ウエーハ対応可能な高搬送機能
High transport function of SiC thin wafer

ガスクラスター ビーム装置 Gas Cluster Beam System/Corrective Etch/Trim

UltraTrimmer Plus™

- 高い精度で狙う厚さと周波数のウェーハプロファイルを達成
Reach targeted thickness and frequency wafer profile with high fidelity
- GCBによる表面の超平坦化機能
Super smooth surface flattening by GCB
- 極薄表面改質機能(酸化・窒化)
Ultra-thin surface modification function
- 膜厚または周波数データに基づくビーム照射制御
Beam irradiation control based on thickness and frequency data
- 理想的な室温プロセス処理
Ideal room temperature process
- 100、150および200mmウェーハのうち2種類を段取り替えなしで対応可能
Enabling two of 100, 150 and 200mm wafer size handling without mechanical change
- RFフィルター(SAW、BAWおよびFBAR)の膜厚・周波数トリミング
RF Filters (SAW, BAW and FBAR) thickness and frequency trimming
- MEMS、フォトマスクの表面平坦化
Surface flattening on MEMS device and photo mask



Mfg:TEL Manufacturing and Engineering of America Inc.

Features

Apps

縦型拡散/LP-CVD/ALD装置 Vertical Diffusion/LP-CVD/ALD Furnace System

ALPHA-8SE™ i

- 長期サポートを見据えパーツ/ユニット/コンポーネントを刷新
Renewed parts, units, and components for life extension
- ALDプロセスに対応: HfO₂, Al₂O₃, SiO₂, AlN, TiO₂など
ALD process capability: HfO₂, Al₂O₃, SiO₂, AlN, TiO₂ and so on
- 装置管理に最適な先進のモニタリング機能
Advanced monitoring function for remote tool management
- Diffusion, LP-CVD, and ALD
- 150/200mmのウェーハサイズに対応
Available for 150 and 200mm wafer



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Features

Apps

UNITY™ Me+

Features

- UNITY™ Meのプロセスチャンバーの設計を変えずにメインコントローラー/搬送ロボットをアップデート
Update the main controller and transfer robot without changing the design of the UNITY™ Me process chambers
- UNITY™ Me+とUNITY™ Me間のレシピ互換性を実現
Realize the process recipe compatibility between UNITY™ Me+ and UNITY™ Me
- UNITY™ IIeからのプロセストレースにも最適
Process trace from UNITY™ IIe is also possible

Apps

- エッチング膜種: 絶縁膜、SiC/Si
Etch layer: Dielectric, SiC/Si
- 100, 150, 200mm ウエーハ対応
100, 150, 200mm wafer applicable



製造: 東京エレクトロン宮城
Mfg: Tokyo Electron Miyagi

リモート接続による装置サポートサービス TELeMetrics™ Remote/Support Service

TELeMetrics™

Features

- 装置データへのリモート接続を基盤とするサービス
Services based on remote access to equipment data
- 装置稼動やアラームを監視、早期の原因解析と是正対応
Monitor equipment status and alarms, quickly analyze causes and take corrective action
- 装置データを多角的に分析、課題に合わせたソリューションの提供
Multifaceted analysis of equipment data and provision of solutions tailored to the issues
- 専用ネットワークによるセキュアな通信
Secure communication via a dedicated network
- リモートトラブルシューティング
Remote Troubleshooting

Apps

- アラーム診断
Alarm Diagnosis
- 生産ロスの解析
Production loss analysis
- 機差マッチング
Machine difference matching
- 装置状態診断
Equipment status diagnosis

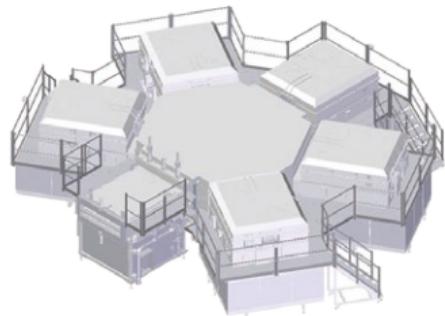


FPD エッティング/アッシング装置 FPD Etch/Ash System

Betelex™

Features

- マルチチャンバーシステムを採用 (最大5基搭載可能)
Multi-chamber system
5 chamber maximum
- 搭載可能ユニット:
PICP™, ECCP
Mountable units:
PICP™, ECCP
- 対応基板サイズ:
G6, G6Half, G8, G8Half
Substrate size:
G6, G6Half, G8, G8Half



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

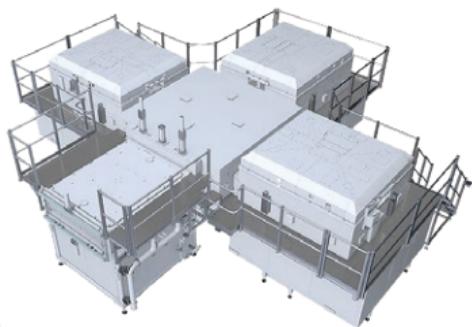
Apps

- シリコン膜エッティング
Silicon layer etch
- 絶縁膜エッティング
Insulating layer etch
- メタル膜エッティング
Metal layer etch
- アッシング
Photoresist ash

Impressio™

Features

- マルチチャンバーシステムを採用 (最大3基搭載可能)
Multi-chamber system
3 chamber maximum
- 搭載可能ユニット:
PICP™, ECCP
Mountable units: PICP™, ECCP
- 対応基板サイズ:
G8, G8Half, G10.5
Substrate size: G8, G8Half, G10.5



製造: 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ
Mfg: Tokyo Electron Technology Solutions

Apps

- シリコン膜エッティング
Silicon layer etch
- 絶縁膜エッティング
Insulating layer etch
- メタル膜エッティング
Metal layer etch
- アッシング
Photoresist ash

TEL PRODUCT LINE-UP

Japanese

www.tel.co.jp/product/

English

www.tel.com/product/

TEL



CLEAN TRACK, LITHIUS Pro, CELLESTA, EXPEDIUS, Episode, Tactras, Certas LEAGA, TELINDY PLUS, NT333, LEXIA, OPTCURE, ORTAS, Triaset+, EX-II, Prexa, WDF, Cellcia, Synapse, Ulucus, ZETA, ViPR, ANTARES, CLEAN TRACK ACT, ACT, Acrevia, UltraTrimmer Plus, ALPHA-8SE, UNITY, TEL e Metrics, Betelex, PICP, Impressio is a registered trademark of Tokyo Electron Group in Japan and/or other countries.

CLEAN TRACK, LITHIUS Pro, CELLESTA, Episode, EXPEDIUS, Tactras, Certas LEAGA, TELINDY PLUS, NT333, LEXIA, OPTCURE, ORTAS, Triaset+, EX-II, Prexa, WDF, Cellcia, Synapse, Ulucus, ZETA, ViPR, ANTARES, CLEAN TRACK ACT, ACT, Acrevia, UltraTrimmer Plus, ALPHA-8SE, UNITY, TEL e Metrics, Betelex, PICP, Impressio are registered trademarks of Tokyo Electron Group in Japan and/or other countries.